OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

LOCTITE ECCOBOND 3593

854256

IDH854256
LOCTITE ECCOBOND 3593 30CC

- Nopeasti kovettuva
- Matalaviskositeettinen
- Jääkaappisäilytettävä
- Nopeatahtiseen tuotantoon

TUOTEKUVAUS

LOCTITE® 3593 on nopeasti kovettuva, matalaviskositeettinen nestemäinen epoksi, joka on suunniteltu underfillaukseen Chip-Size komponenteille. (CSP). Se on optimoitu nopeatahtiseen tuotantoon, jossa prosessinopeus on kriittinen tekijä.
Räätälöidyn reologiansa ansiosta LOCTITE® 3593 tunkeutuu luotettavasti jopa 25 µm kokoisiin rakoihin varmistaen täydellisen underfillauksen. Materiaali on helppo annostella, se minimoi komponentteihin kohdistuvat jännitykset ja tarjoaa erinomaisen kestävyyden lämpötilasykleissä. Lisäksi sillä on erinomainen kemiallinen kestävyys, mikä takaa pitkäaikaisen luotettavuuden.
Kylmien lähetysten vastaanotto:
Kaikki kuljetuslaatikot on pakattu kylmägeelipakkauksilla, jotta lämpötila pysyy alle **8 °C:n** kuljetuksen aikana.
Lämpötilan tasaantuminen:
Uusi materiaalipakkaus voidaan saattaa huoneenlämpöön antamalla sen seistä huoneenlämmössä (**22 ± 2 °C**) **1–2 tunnin ajan** (todellinen tarvittava aika riippuu pakkauksen koosta ja tilavuudesta).
Älä löysää astioiden kansia, korkkeja tai suojuksia:
Ruiskupakkaukset on annettava tasaantua **kärki alaspäin -asennossa**.

Lämpöä ei saa koskaan käyttää, sillä **osittainen polymeroituminen (kovettuminen)** voi tällöin käynnistyä.

TEKNISET TIEDOT

Kovettumisaika	3 min @ 165C / 5 min @ 150C
Kovetusmenetelmä	Korotettu lämpötila
Kovuus	88 ShD
Lämmönjohtavuus	0,21 W/mk
Sekoitussuhde	Yksikomponenttinen
Sovellus	Underfill
Säilyvyys	6 kuukausi
Varastointi	Jääkaappisäilytys (+2..+8C)
Väri	Musta